2016年3月期
決算説明会

2016年5月11日

TOWA株式会社

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

本日の主な説明内容

１．2016年3月期　実績

２．2017年3月期　業績予想

３．ＴＯＷＡの取組みと戦略

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

本日の主な説明内容

１．2016年3月期　実績

２．2017年3月期　業績予想

３．ＴＯＷＡの取組みと戦略

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

2016年 3月期 連結業績結果（前年比）

（単位：億円）

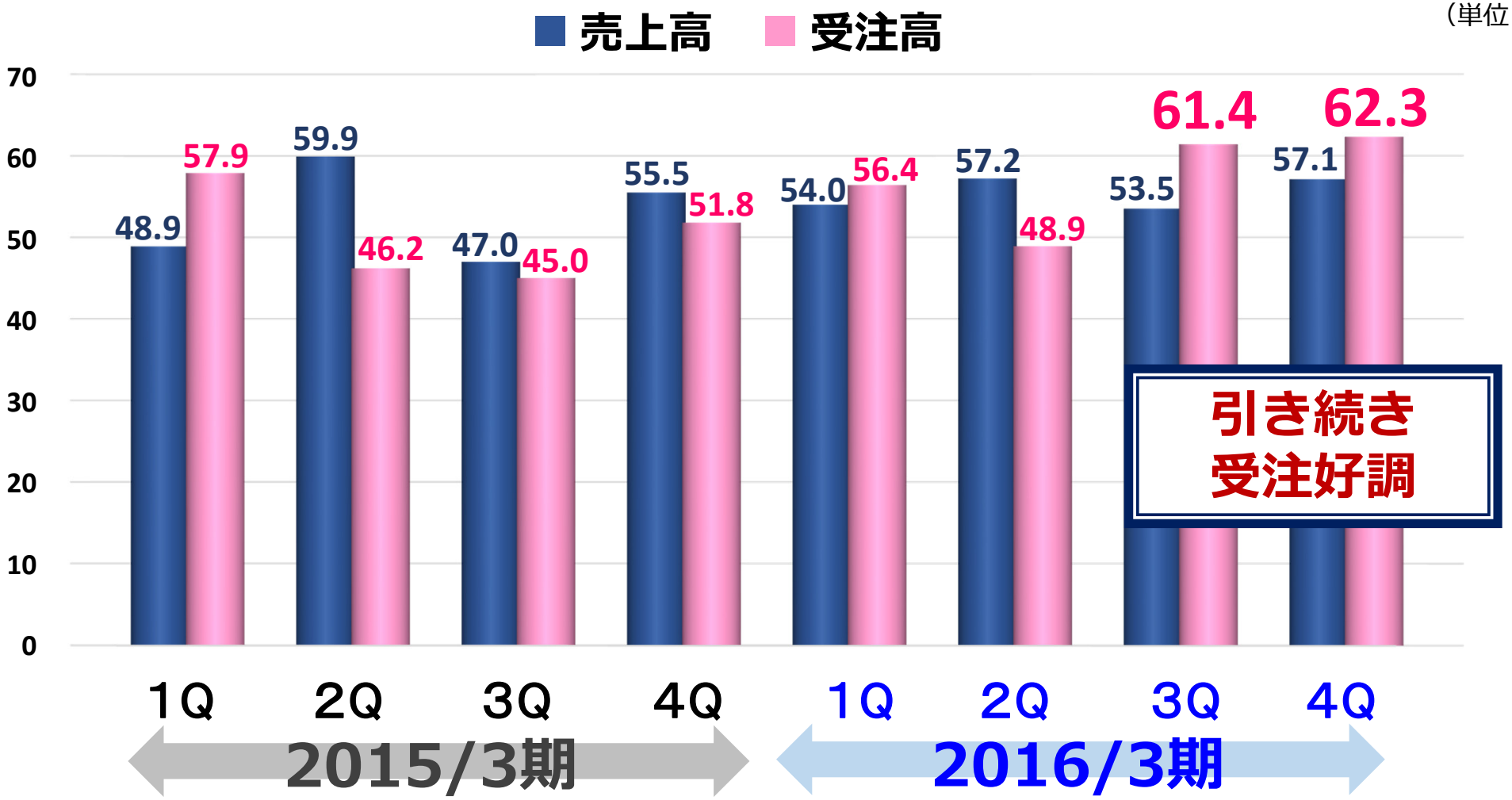
	2015/3期 実績	当初計画	修正予想① (10/21修正公表)	修正予想② (2/9修正公表)	実績	前年比
売　上　高	211.5	225.0	197.0	210.0	221.8	＋ 4.8%
営 業 利 益	19.7	23.5	9.0	15.0	19.4	▲ 1.5%
経 常 利 益	22.9	23.5	9.0	16.0	20.5	▲10.4%
当期純利益	19.3	19.7	8.0	15.0	17.9	▲ 7.2%

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

受注・売上高の推移

（単位：億円）



2016年 3月期 セグメント別売上高

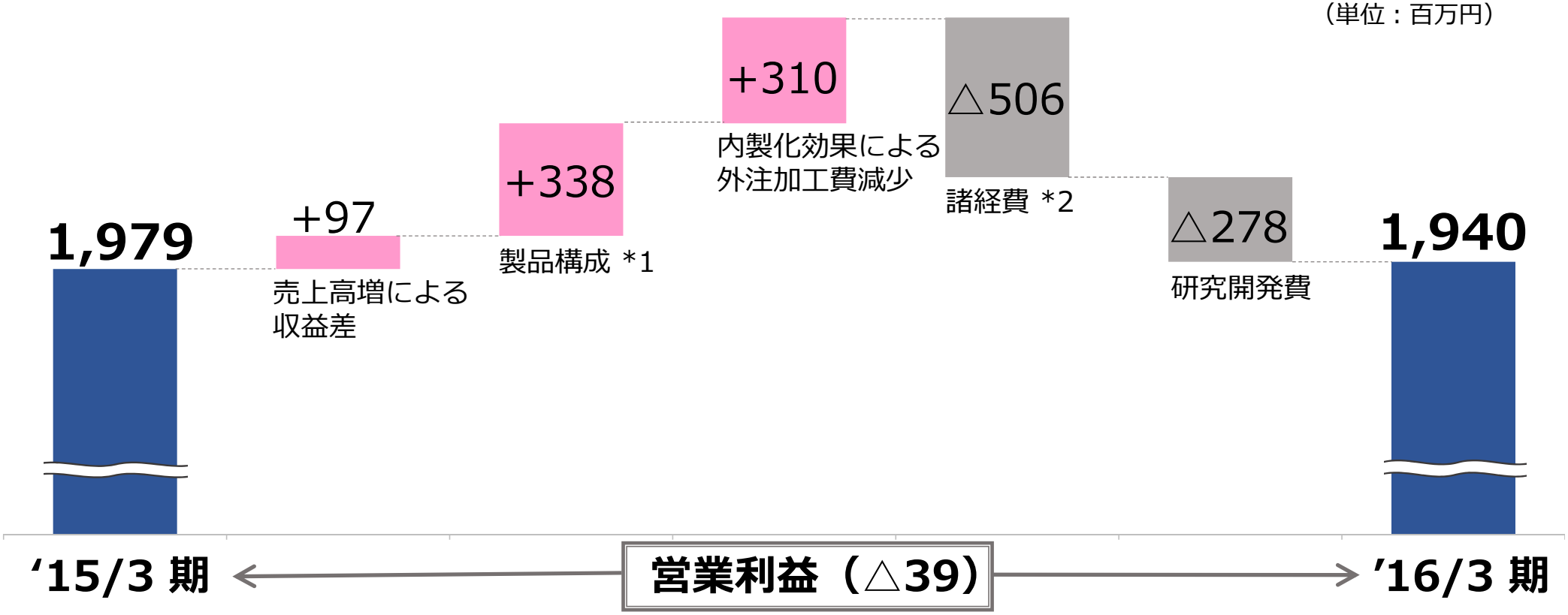
（単位：億円）

	2015/3期 実績	2016/3期 実績	増加額	前年比
売上高	211.5	221.8	+ 10.3	+ 4.8%
半導体事業	183.7	192.0	+ 8.3	+ 4.5%
既存半導体以外の事業	26.3	24.6	▲ 1.7	▲ 6.4%
新事業	1.4	4.9	+ 3.5	+ 250.0%

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

連結営業利益　増減要因分析

（単位：百万円）



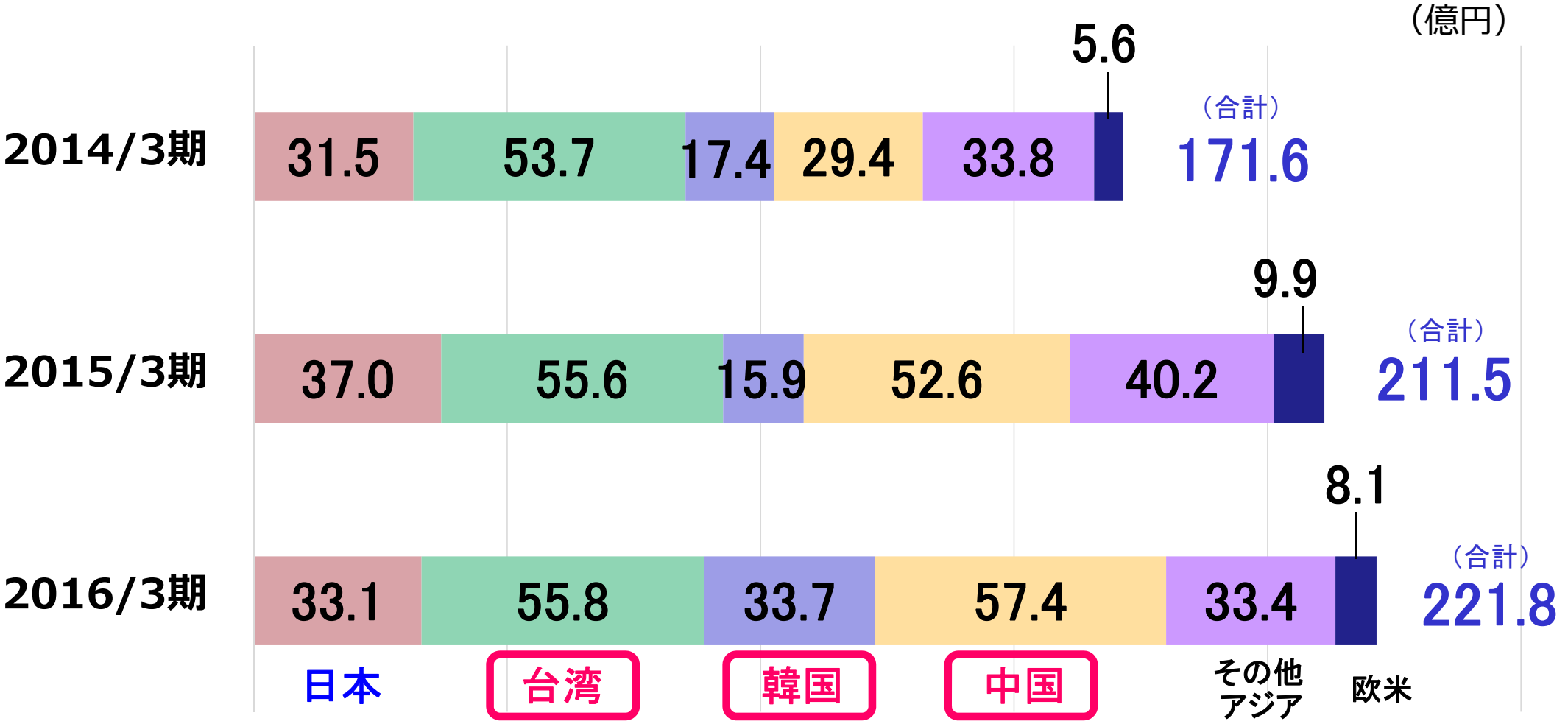
*1 コンプレッション比率増による影響額
構成比　前期 33.6 % →　当期 45.9 %

*2 内訳：

人員増による	△ 120	販売促進による費用増	△ 116
ラボ機能の充実	△ 157	新規設備導入による償却費増	△ 113

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

地域別売上高推移（仕向地ベース）



This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

本日の主な説明内容

1．2016年3月期　実績

2．2017年3月期　業績予想

3．ＴＯＷＡの取組みと戦略

2017年 3月期 連結業績計画

（単位：億円）

	2016/3期 実績	2017/3期 計画	増加額	前年比
売　上　高	221.8	235.0	+ 13.2	+ 5.9%
営 業 利 益	19.4	21.0	+ 1.6	+ 8.2%
経 常 利 益	20.5	21.0	+ 0.5	+ 2.4%
当期純利益	17.9	19.0	+ 1.1	+ 6.1%

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

2017年 3月期 セグメント別売上高 計画

（単位：億円）

	2016/3期 実績	2017/3期 計画	増加額	前年比
売上高	221.8	235.0	+ 13.2	+ 5.9%
半導体事業	192.1	199.0	+ 6.9	+ 3.6%
既存半導体以外の事業	24.6	21.0	▲ 3.6	▲ 14.6%
新事業	4.9	15.0	+ 10.1	+ 206.1%

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

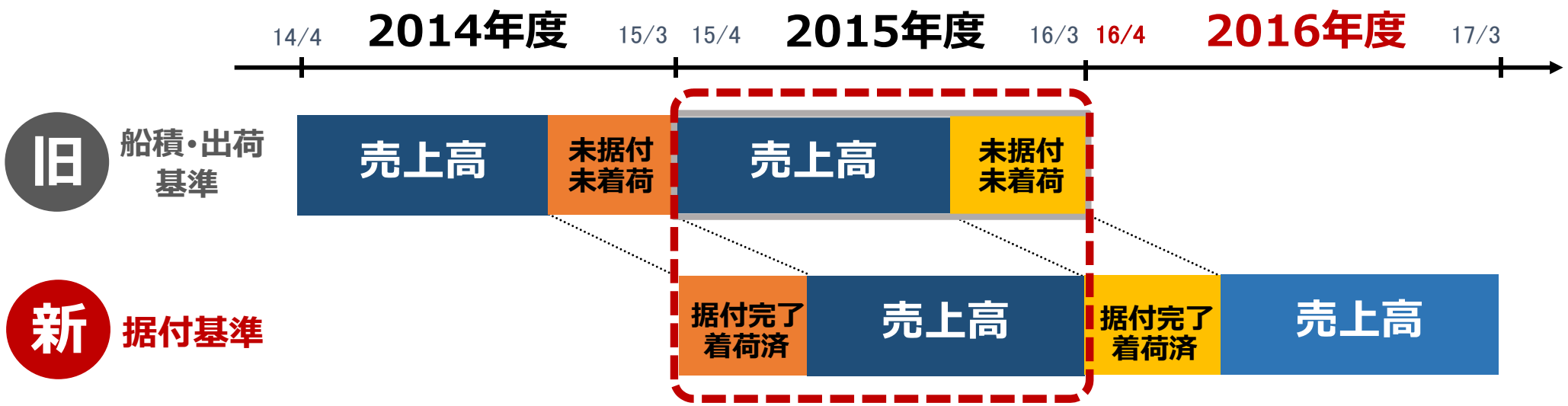
設備投資・配当計画

	2016/3期 実績	2017/3期 計画
設備投資	19.9億円	20.0億円
配　　当	10.0 円	10.0 円

※配当方針「安定・継続配当」に基づき、期末10.0円を予定。

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

収益認識基準の変更



■変更内容：[旧基準]　船積・出荷日
　　[新基準]　据付完了日・着荷日

■適用時期：2017年3月期 期初（2016年4月～）

■変更理由：収益の実態をより適切に反映させるとともに、
　　国際的な会計基準との調和を図る。

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

本日の主な説明内容

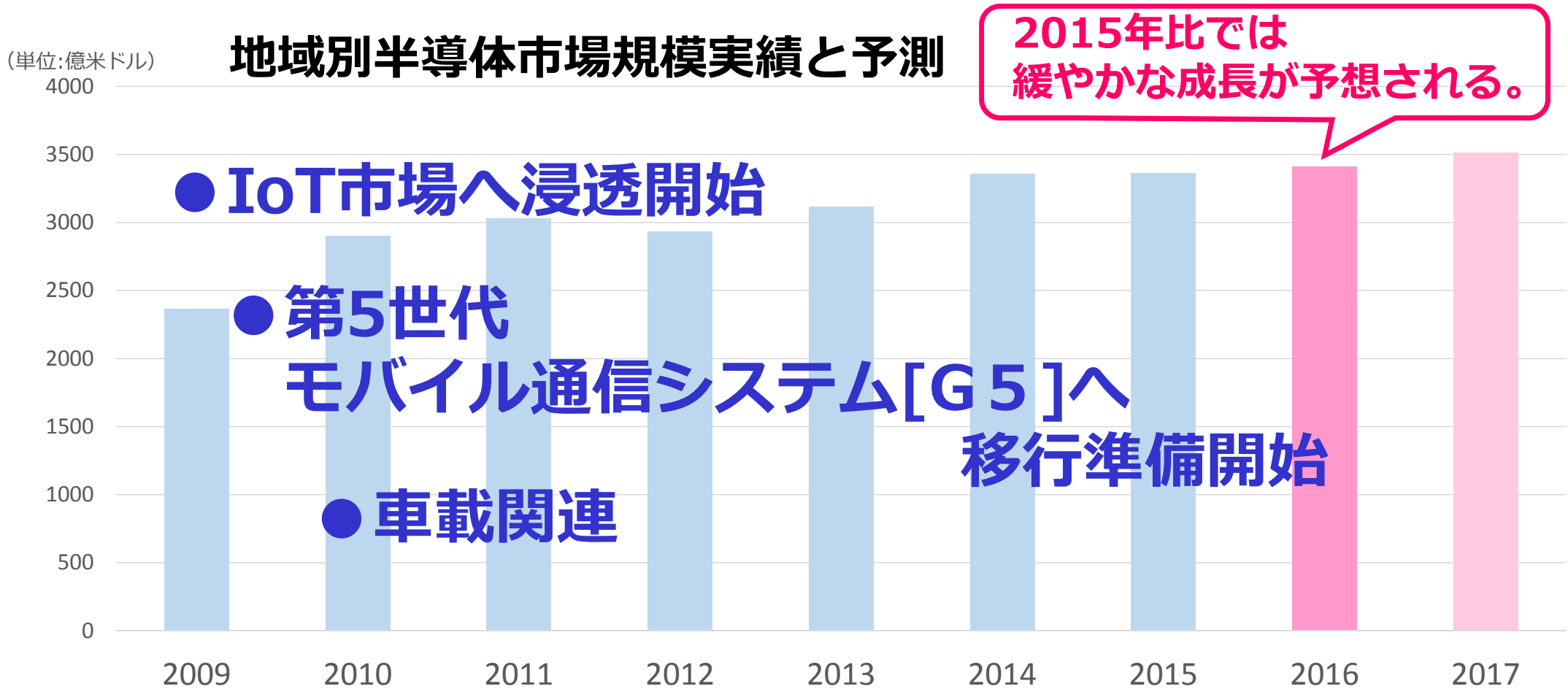
１．2016年3月期　実績

２．2017年3月期　業績予想

３．ＴＯＷＡの取組みと戦略

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

2016年 半導体市況

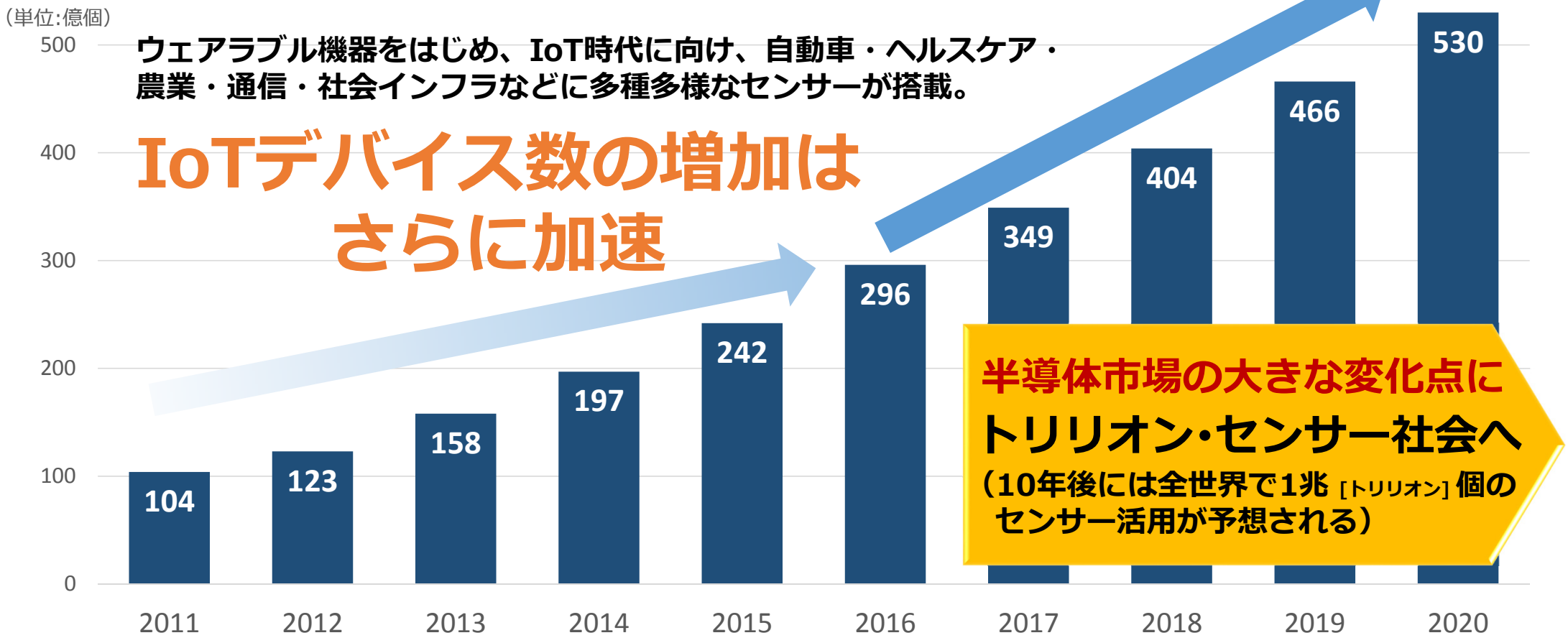


資料：WSTS発表資料より当社作成。2014年までは実績値。2015年以降は予測値。

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

電子デバイス産業の動向

IoT時代へ加速　―トリリオン時代へ―



ウェアラブル機器をはじめ、IoT時代に向け、自動車・ヘルスケア・農業・通信・社会インフラなどに多種多様なセンサーが搭載。

IoTデバイス数の増加はさらに加速

半導体市場の大きな変化点に

トリリオン・センサー社会へ

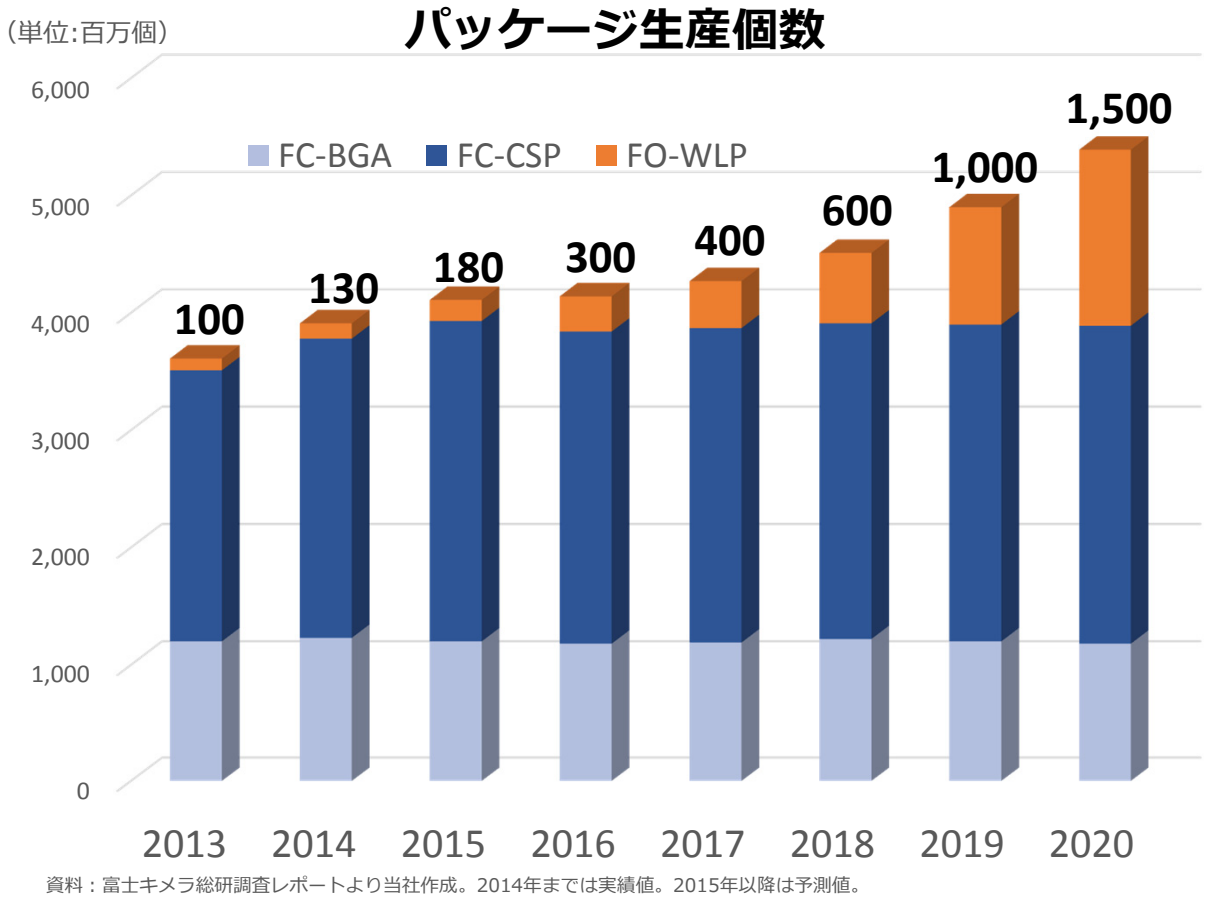
（10年後には全世界で1兆［トリリオン］個のセンサー活用が予想される）

資料：「平成27年度情報通信白書」より当社作成。2014年までは実績値。2015年以降は予測値。

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

ウエハーレベルパッケージ成長予測

ファンアウト型WLP市場は今後数年の間に大きく成長



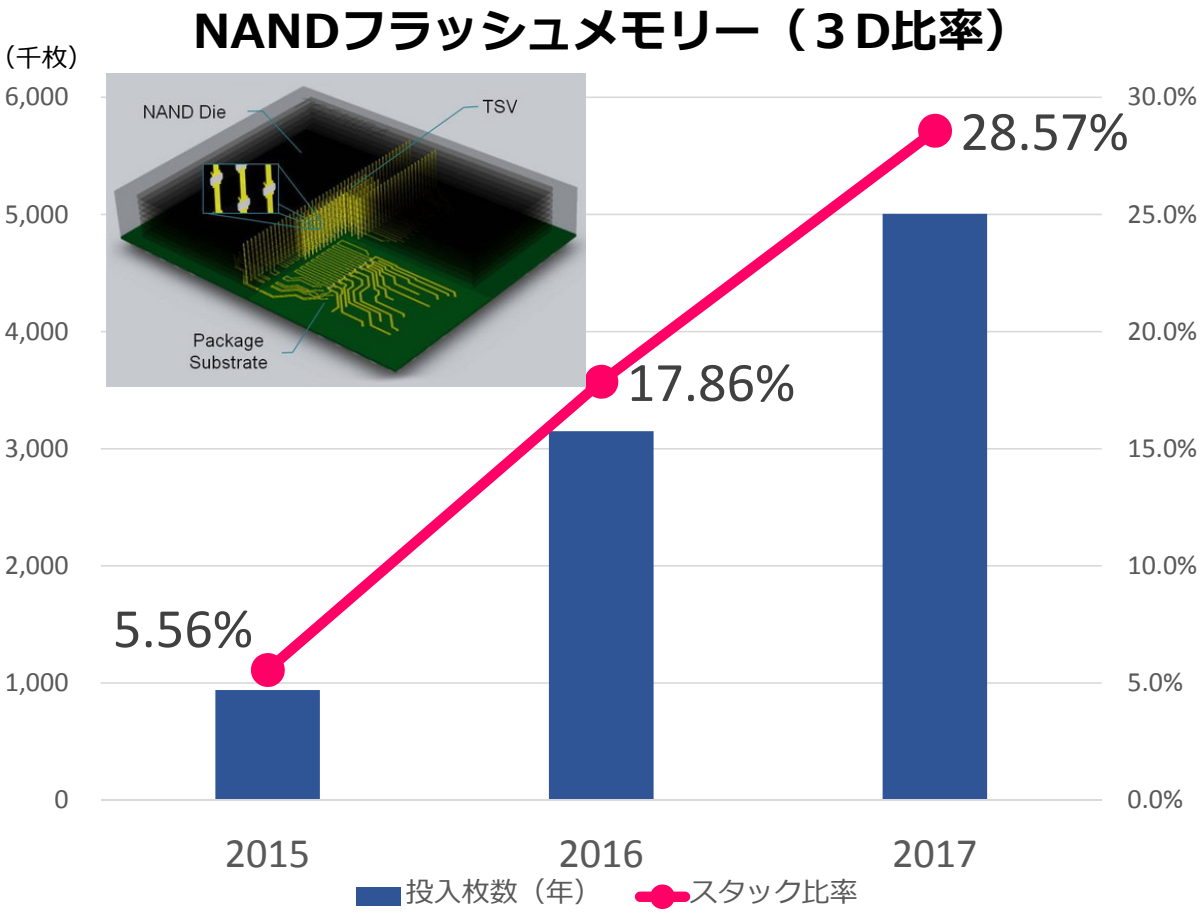
資料：富士キメラ総研調査レポートより当社作成。2014年までは実績値。2015年以降は予測値。

- **2016年 スマホ用アプリケーション プロセッサー(AP)に採用予定**
- **フリップチップサイズ パッケージ(FC-CSP)からの 置き換え**
  - 基板の大型化によるコスト低減
  - 様々なアプリケーションへの展開
  - 生産性向上
  - ウエハーのみならず パネルへの展開も視野

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

電子デバイス産業の動向

半導体の進化 → 3次元（3D-IC）への移行



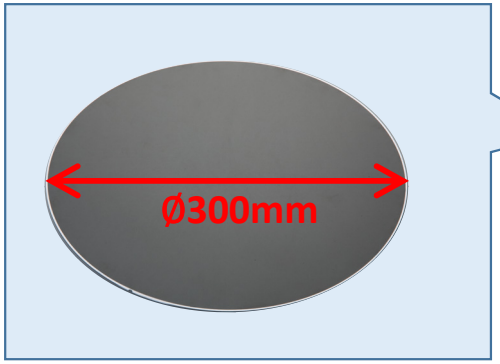
- **スマホの高機能化**
  - 省スペース
  - 高速化
  - 低消費電力
- **データセンターの性能向上**
- **HDDからの置き換え**
  - SSDの台頭

資料：「電子デバイス産業新聞調べ」より当社作成。

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

TOWAの取組みと戦略

半導体事業　コンプレッション技術の展開

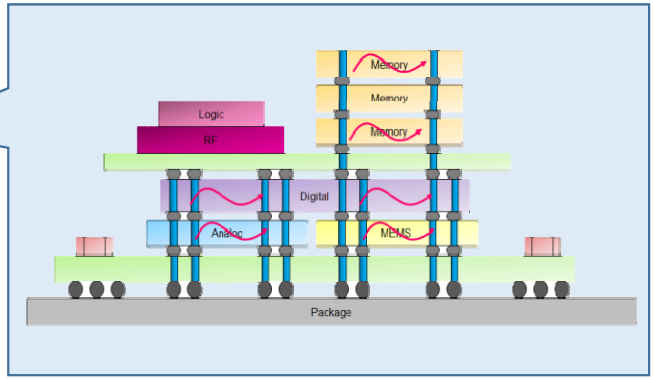


ウエハーレベル

低背化
大判化

SiP
(System in a Package)

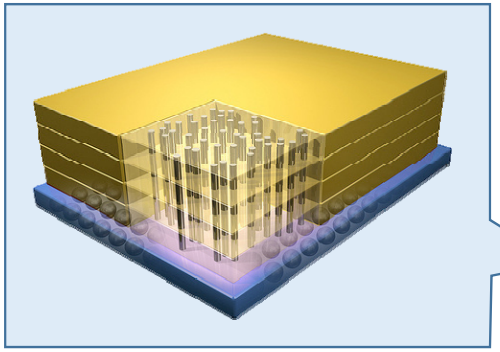
モジュール化
省スペース
組立工数削減



コンプレッション技術

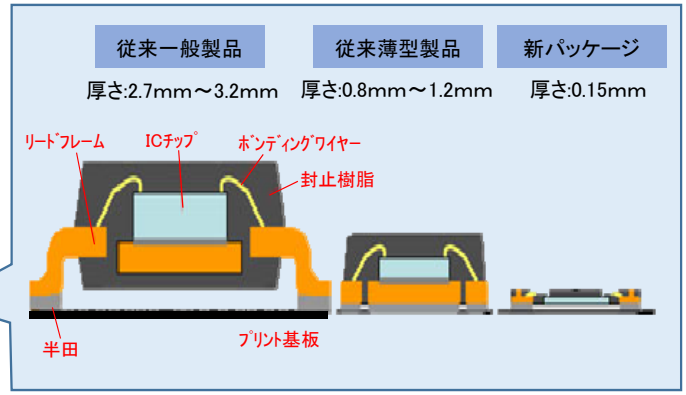
メモリー大容量化
高速性能

3D-IC



組込部品
指紋センター

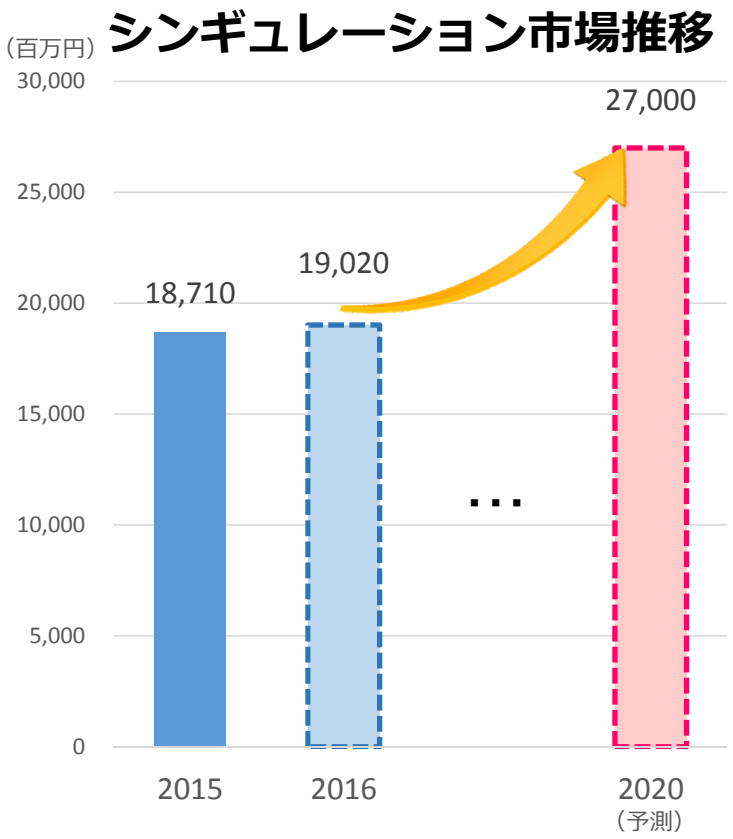
薄型パッケージ



This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

TOWAの取組みと戦略

半導体事業　シンギュレーション

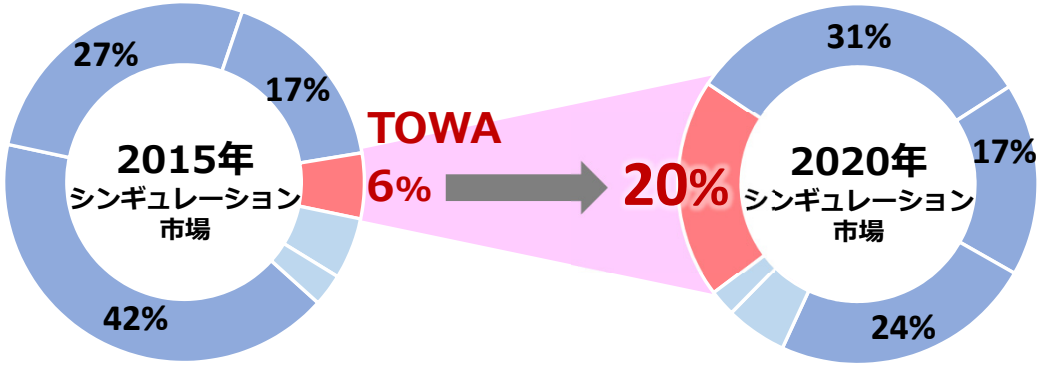


資料：グローバルネット㈱「世界半導体製造装置・試験/検査装置市場」より当社作成。

●IoTデバイス数の増加により、2020年には
WLCSP込みで270億円以上の市場規模へ

３つの強みで、市場シェア拡大を目指す

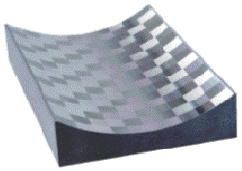
1．高生産性（業界最速）
2．高品質
3．TSSによる充実したサービス



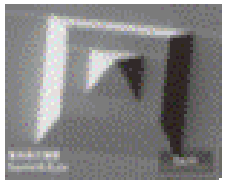
This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

TOWAの取組みと戦略

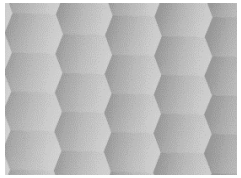
超精密加工
R形状cavity



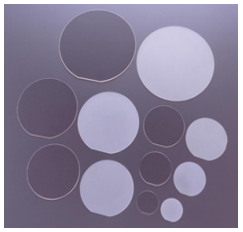
EF・超微細加工



マイクロレンズアレイ



カバーガラス



バンセラ
コーティング

ナノテク

ガラス加工

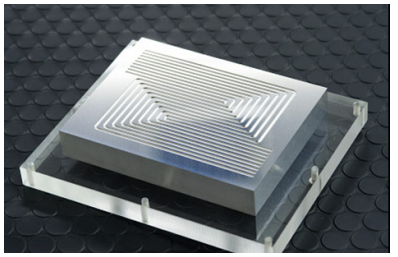
TOWA
コア技術

ツール

コーティング

TSS

車載関連部品



ＣＢＮエンドミル

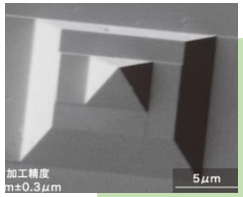
TEN-System

TOWAの取組みと戦略

新組織「新事業推進本部」を設置

研究・開発・技術・製造部門から専属配置し、
新事業の加速度的発展を目指す。

コーティング ― バンセラ®



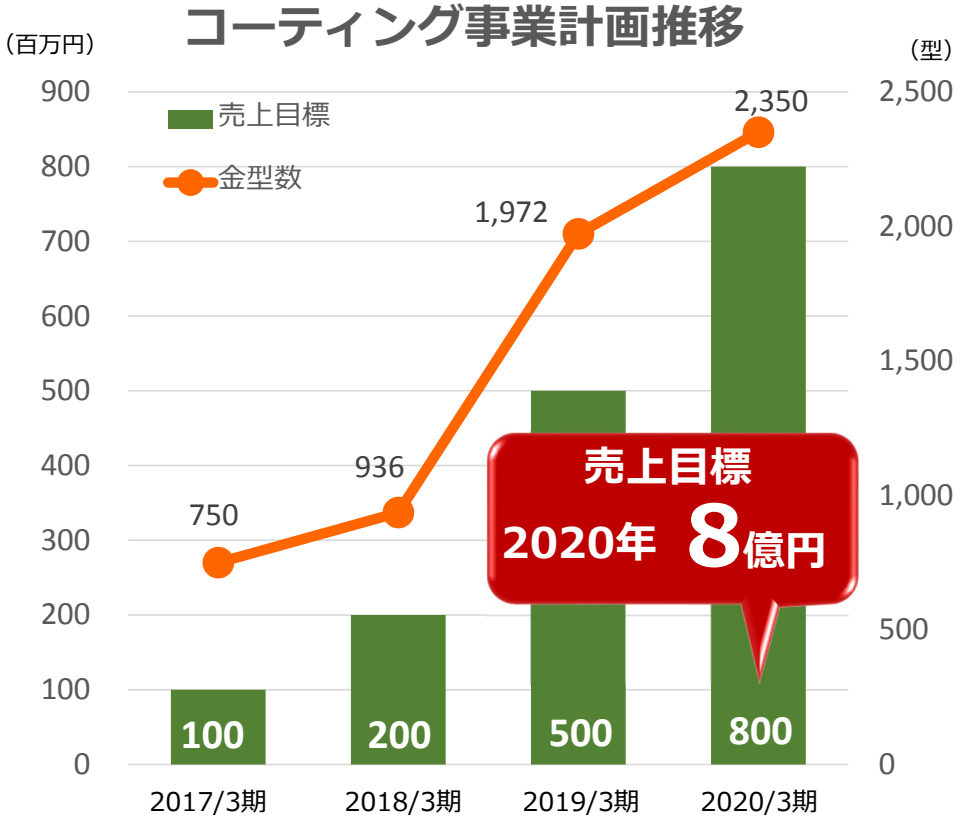
ナノテク ― 超微細加工・車載関連

ツーリング ― CBN工具

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

TOWAの取組みと戦略

新事業　コーティング（バンセラ）



展 開

医薬品打錠機 関連
強化ガラス 関連
受託コーティング

取組み

当社金型に全面採用決定

・金型付加価値向上
・リピート金型

新事業分野への展開

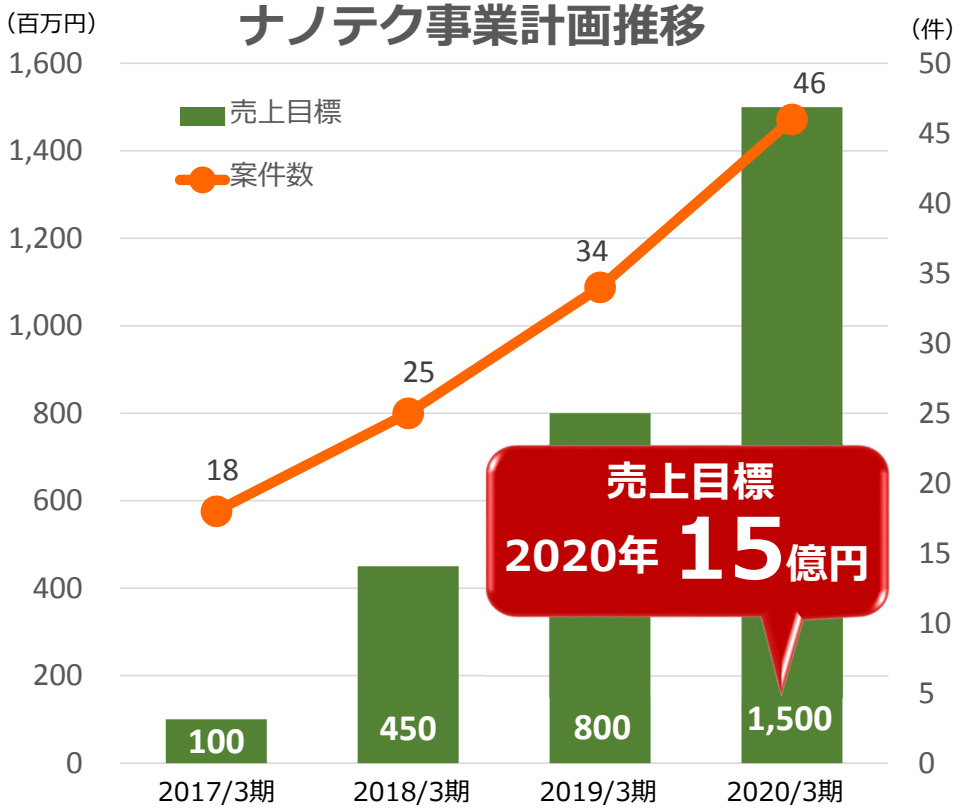
基本性能

耐摩耗性に優れ **表面を高硬度化**
撥水性が高く **優れた防汚性**

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

TOWAの取組みと戦略

応用展開　新事業　ナノテク（超微細加工）



展 開

コア技術活用による
受託加工受注拡大

微細印刷用原版

取組み

車載 関連・光学系
マイクロレンズ球面･非球面

テスト端子・燃料電池 関連

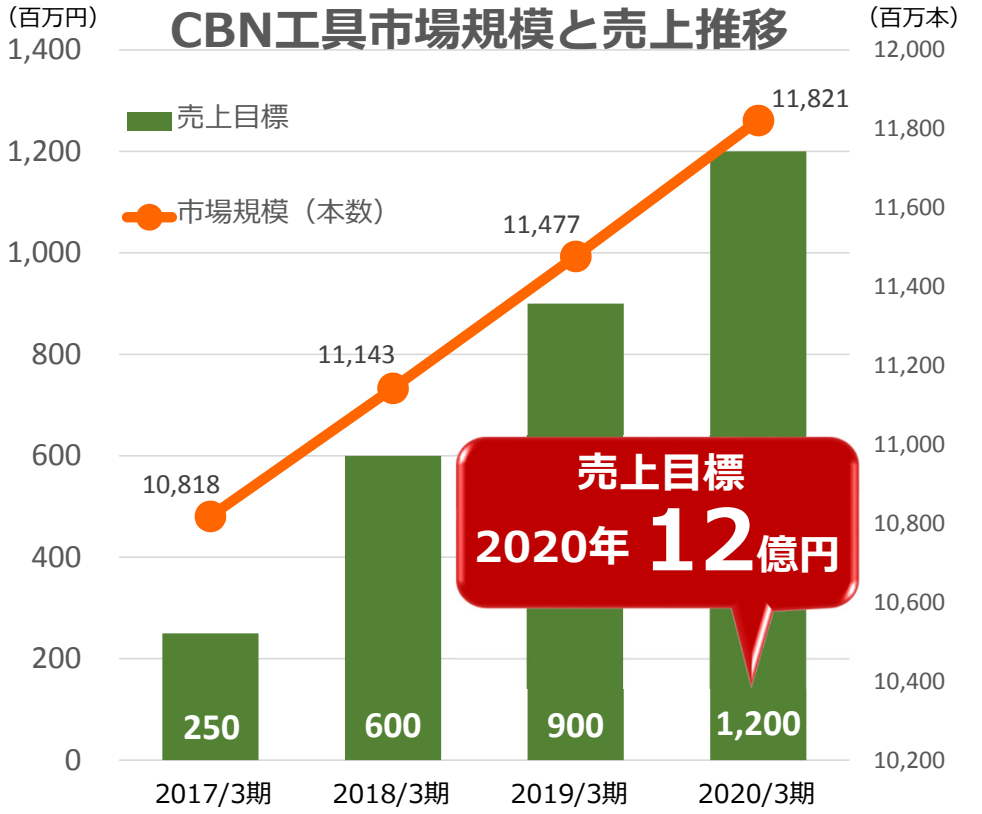
基本性能

ＥＦ技術で多様なご要望に応える
超微細形状加工技術
高性能で低コスト
超精密微細金型複製技術

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

TOWAの取組みと戦略

新事業　ツーリング（CBN工具）



資料：経産省データより当社作成。

展 開

高硬度の難削材の台頭による
加工効率･高精度･仕上げ面粗度要求に応え
グローバル展開

取組み

独自商品の開発
ラインナップの充実

性能向上

基本性能

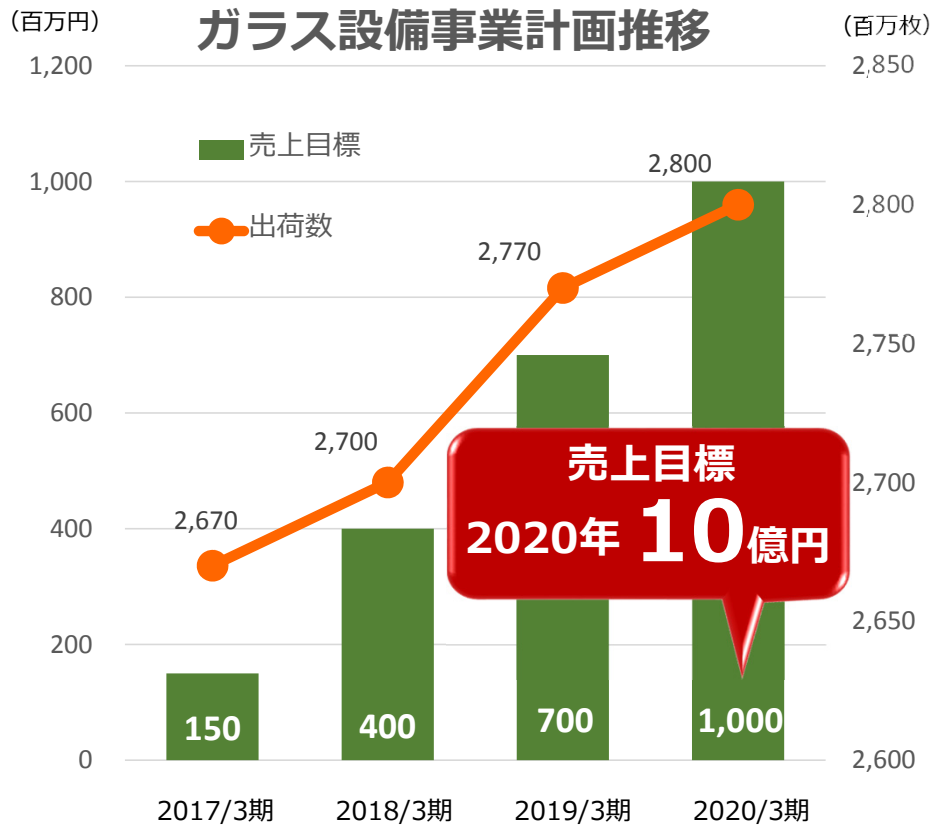
高精度･長寿命･低価格

短納期で **再研削･特注品対応**

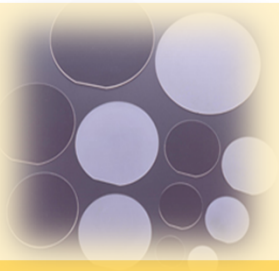
This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

TOWAの取組みと戦略

新事業　ガラス加工



展 開



スマホレンズ
カバーガラス
半導体

取組み

強化ガラス
薄板ガラス
サファイアガラス

基本性能

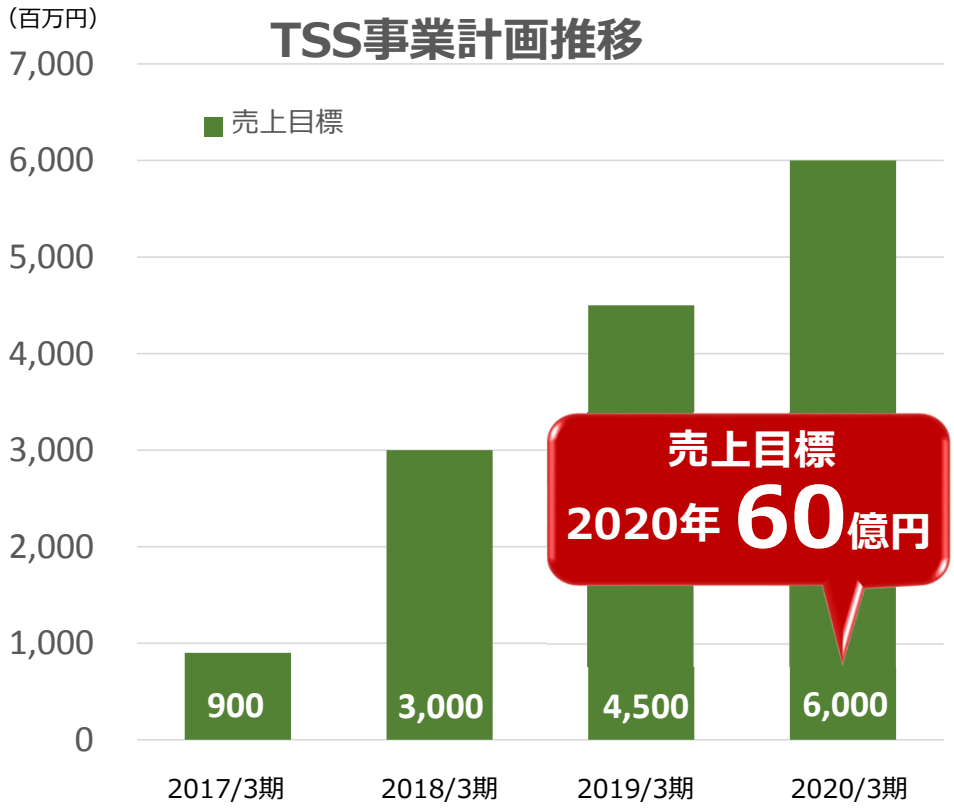
フィルムを用いたダメージのない加工
・穴あけ　・切断

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

TOWAの取組みと戦略

半導体事業 | 応用展開 | 新事業

TSS事業



展 開

グローバルサービス体制

部品供給･トレーニング･改善/改良提案

取組み

IoT・TEN-System
メンテナンス契約
遠隔支援システム
部品在庫管理

基本性能

提案力･データベース

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION

プライベートショー開催

変革 -Revolution-

未来に向かう、知の技術

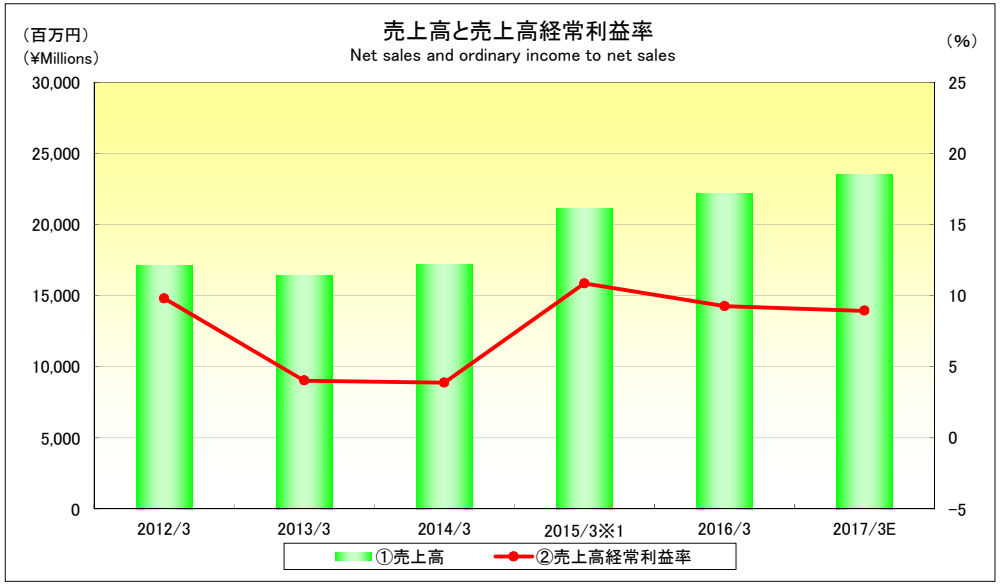
TOWA PRIVATE SHOW 2016

May.09 - June.30 2016

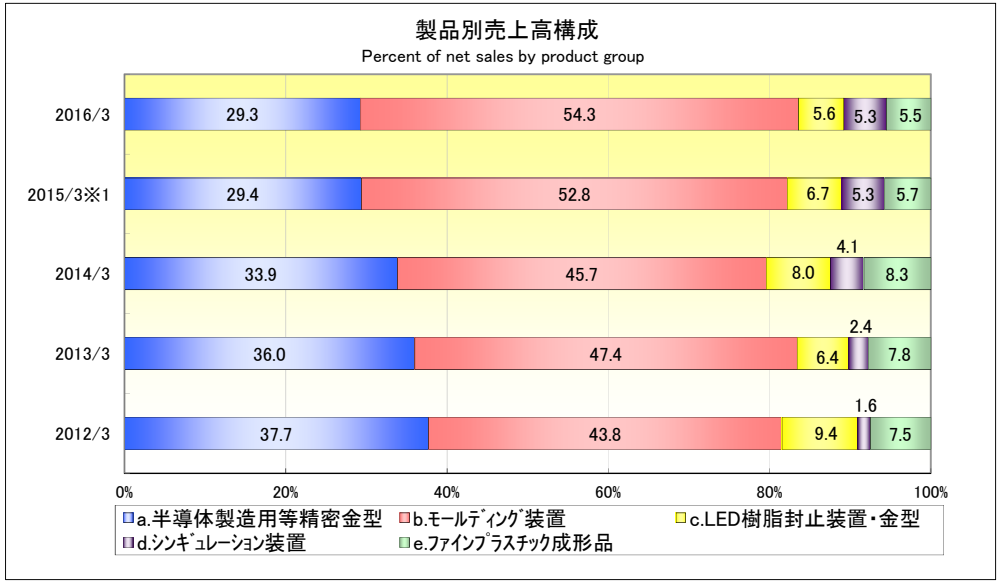
【展示内容】

CPM1180・CPM1080・PMC1040
YPM-SP・PSS1020・FMS3040 等

This material is confidential and the property of TOWA CORPORATION



①Net sales ②Ordinary income to net sales

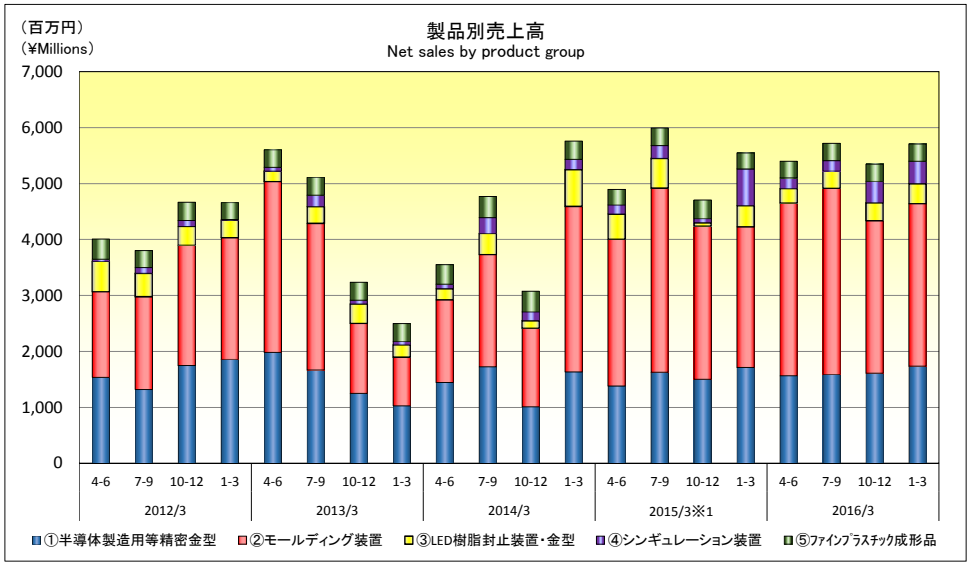


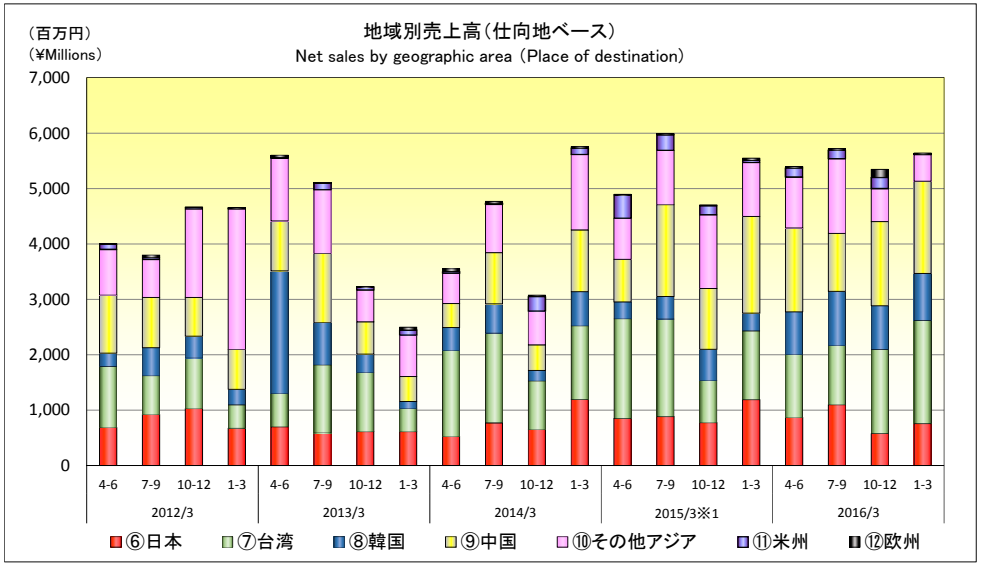
a.Precision molds b.Semiconductor plastic encapsulation systems c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED
d.Singulation parts and systems e. Engineering plastic molded products

決算期	Fiscal year	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3※1	2016/3	2017/3E	2015/9	2016/9E
経営成績・財政状態（百万円）	Operating results and financial conditions (¥Millions)								
売上高	Net sales	17,140	16,454	17,165	21,150	22,186	23,500	11,124	11,700
経常利益	Ordinary income	1,672	663	666	2,296	2,057	2,100	1,205	1,020
親会社株主に帰属する当期純利益 ※2	Profit attributable to owners of parent※2	968	691	568	1,934	1,790	1,900	1,167	920
総資産	Total assets	26,817	25,896	29,132	31,735	32,327	–	30,905	–
純資産	Net assets	15,926	17,072	17,909	21,060	21,947	–	21,491	–
1株当たり指標（円）	Per share data（¥）								
1株当たり当期純利益	Net income per share	38.71	27.64	22.72	77.35	71.60	75.97	46.67	36.78
諸指標（%）	Data（%）								
自己資本当期純利益率	Return on equity	6.3	4.2	3.3	10.1	8.5	–	–	–
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	6.2	2.5	2.4	7.5	6.4	–	–	–
売上高経常利益率	Ordinary income to net sales	9.8	4.0	3.9	10.9	9.3	8.9	10.8	8.7
自己資本比率	Equity ratio	59.4	65.2	60.6	65.4	66.8	–	68.5	–

※1 2016年3月期より会計方針の変更を行っているため、「2015/3」については、遡及適用後の数値を記載しております。
※2 2016年3月期より会計基準等の改正に伴い、従来の「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」となります。

Ⅱ．四半期売上高動向（連結） Quarterly Net Sales （Consolidated）





製品別売上高 Net sales by product group

（単位：百万円/¥Millions）

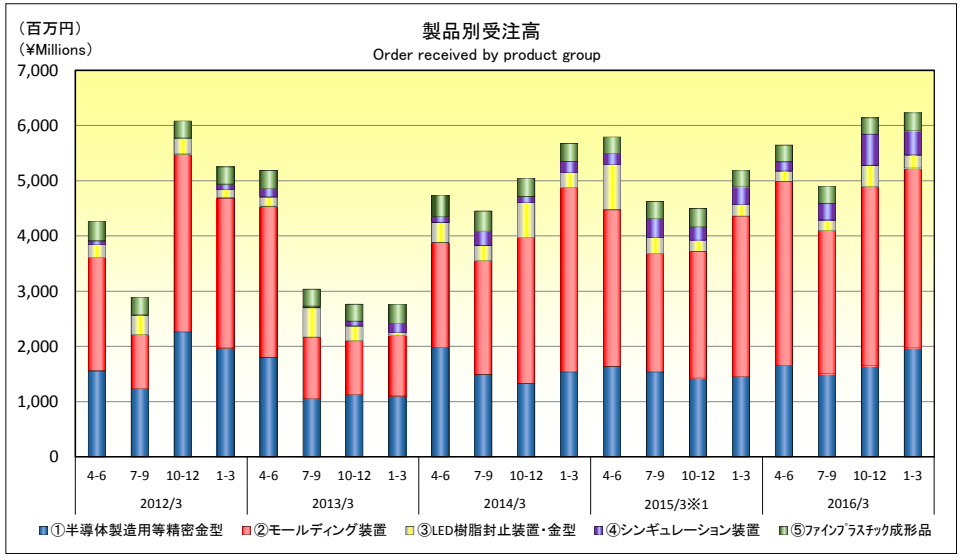
決算期	Fiscal year	2012/3					2013/3					2014/3					2015/3※1					2016/3				
		4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計	Total sales	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454	3,555	4,772	3,076	5,761	17,165	4,897	5,995	4,706	5,550	21,150	5,401	5,722	5,350	5,711	22,186
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds		1,537	1,320	1,745	1,859	6,462	1,984	1,665	1,247	1,026	5,923	1,443	1,723	1,009	1,634	5,810	1,383	1,625	1,500	1,711	6,220	1,565	1,590	1,610	1,734	6,501
モールディング装置 ②Semiconductor plastic encapsulation systems		1,529	1,657	2,152	2,173	7,513	3,052	2,623	1,254	870	7,801	1,479	2,007	1,406	2,958	7,852	2,620	3,293	2,738	2,516	11,169	3,088	3,324	2,725	2,908	12,047
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED		544	418	333	312	1,608	187	299	347	220	1,055	197	378	133	657	1,367	451	532	62	378	1,425	256	310	321	356	1,243
シンギュレーション装置 ④Singulation parts and systems		38	104	111	12	267	67	204	65	57	395	82	285	158	182	710	163	231	71	658	1,125	190	188	385	402	1,167
ファインプラスチック成形品 ⑤Engineering plastic molded products		359	303	323	301	1,287	311	318	322	325	1,277	351	377	367	327	1,424	279	311	333	285	1,210	300	308	307	309	1,226
月平均		1,336	1,268	1,555	1,553	1,428	1,868	1,704	1,079	834	1,371	1,185	1,591	1,025	1,920	1,430	1,632	1,998	1,569	1,850	1,763	1,800	1,907	1,783	1,904	1,849

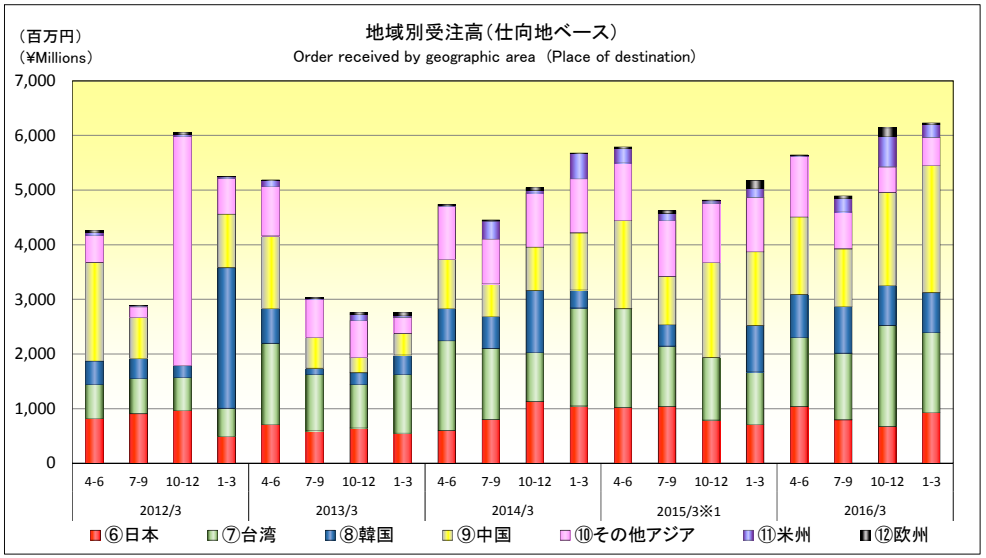
地域別売上高（仕向地ベース） Net sales by geographic area (Place of destination)

（単位：百万円/¥Millions）

決算期	Fiscal year	2012/3					2013/3					2014/3					2015/3※1					2016/3				
		4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計	Total sales	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454	3,555	4,772	3,076	5,761	17,165	4,897	5,995	4,706	5,550	21,150	5,401	5,722	5,350	5,711	22,186
日本	⑥Japan	688	925	1,030	675	3,320	702	590	614	614	2,521	527	772	654	1,195	3,150	849	884	776	1,190	3,701	870	1,100	577	761	3,310
台湾	⑦Taiwan	1,103	695	912	421	3,132	595	1,227	1,068	423	3,314	1,556	1,619	873	1,326	5,376	1,800	1,761	762	1,241	5,565	1,137	1,069	1,518	1,861	5,587
韓国	⑧Korea	237	510	393	282	1,423	2,215	764	329	119	3,428	408	528	189	618	1,745	305	408	561	319	1,594	768	973	791	844	3,377
中国	⑨China	1,050	903	701	718	3,374	903	1,248	583	453	3,189	436	926	462	1,116	2,941	767	1,654	1,099	1,747	5,269	1,512	1,047	1,520	1,664	5,746
その他アジア	⑩Other asia	823	688	1,598	2,539	5,649	1,129	1,151	575	748	3,604	543	870	609	1,361	3,384	743	980	1,328	972	4,025	920	1,348	593	482	3,345
米州	⑪America	94	32	25	11	164	14	112	53	89	269	31	20	263	112	428	418	282	162	40	904	163	154	200	70	589
欧州	⑫Europe	10	47	4	11	74	44	16	12	52	126	51	34	23	29	137	12	23	15	39	89	27	28	147	26	230

※1 2016年3月期より会計方針の変更を行っているため、「2015/3」については、遡及適用後の数値を記載しております。





製品別受注高 Order received by product group （単位：百万円/¥Millions）

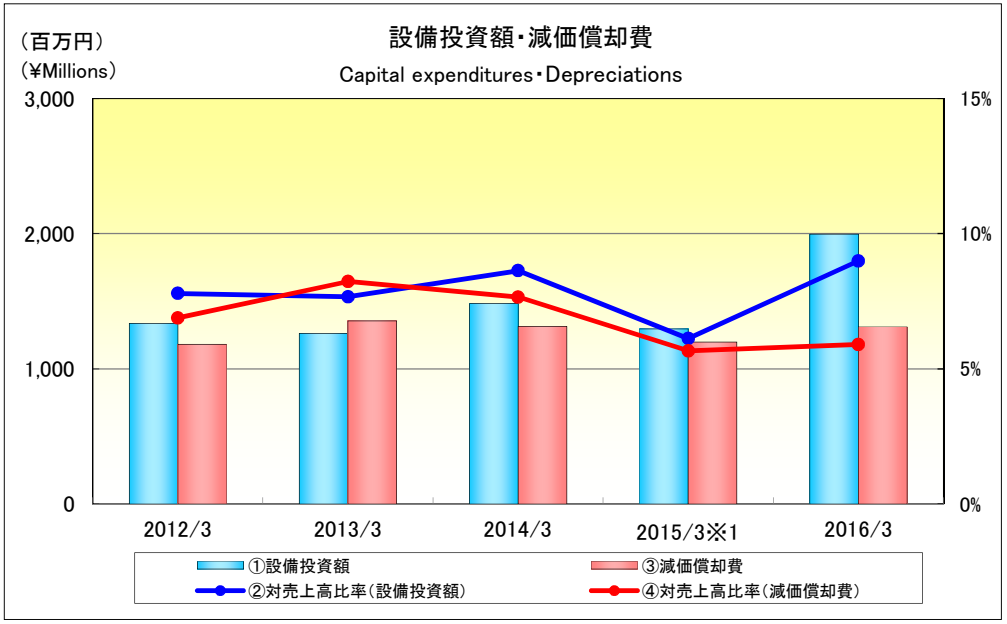
決算期 Fiscal year	2012/3 4-6	7-9	10-12	1-3	通期	2013/3 4-6	7-9	10-12	1-3	通期	2014/3 4-6	7-9	10-12	1-3	通期	2015/3※1 4-6	7-9	10-12	1-3	通期	2016/3 4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759	4,740	4,454	5,048	5,677	19,921	5,794	4,626	4,501	5,182	20,104	5,648	4,897	6,140	6,232	22,918
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	1,558	1,236	2,263	1,969	7,028	1,797	1,052	1,131	1,101	5,083	1,980	1,490	1,326	1,539	6,336	1,633	1,539	1,428	1,453	6,054	1,661	1,502	1,647	1,972	6,784
モールディング装置 ②Semiconductor plastic encapsulation systems	2,055	982	3,221	2,720	8,978	2,741	1,119	970	1,103	5,934	1,904	2,067	2,643	3,339	9,954	2,842	2,144	2,294	2,909	10,191	3,324	2,594	3,247	3,259	12,425
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	227	348	289	147	1,013	168	529	270	53	1,021	365	275	642	273	1,556	820	289	204	210	1,524	193	192	387	237	1,010
シンギュレーション装置 ④Singulation parts and systems	73	16	−29	103	164	160	30	90	158	439	107	257	101	198	664	203	350	240	316	1,111	166	302	565	435	1,470
ファインプラスチック成形品 ⑤Engineering plastic molded products	350	307	309	313	1,281	322	306	304	346	1,279	383	362	335	327	1,409	294	303	333	292	1,223	302	304	292	327	1,227
月平均	1,422	964	2,018	1,752	1,539	1,730	1,013	922	921	1,147	1,580	1,485	1,683	1,892	1,660	1,931	1,542	1,500	1,727	1,675	1,883	1,632	2,047	2,077	1,910

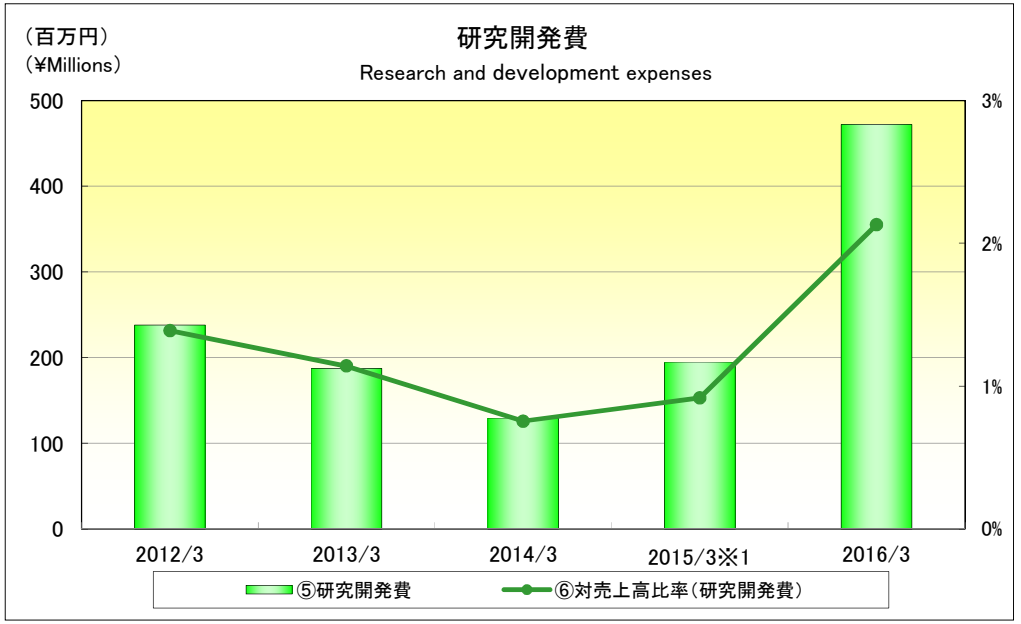
地域別受注高 （仕向地ベース） Order received by geographic area （Place of destination） （単位：百万円/¥Millions）

決算期 Fiscal year	2012/3 4-6	7-9	10-12	1-3	通期	2013/3 4-6	7-9	10-12	1-3	通期	2014/3 4-6	7-9	10-12	1-3	通期	2015/3※1 4-6	7-9	10-12	1-3	通期	2016/3 4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759	4,740	4,454	5,048	5,677	19,921	5,794	4,626	4,501	5,182	20,104	5,648	4,897	6,140	6,232	22,918
日本 ⑥Japan	821	906	963	495	3,187	703	593	645	551	2,494	602	802	1,130	1,048	3,583	1,023	1,036	789	709	3,558	1,035	795	672	934	3,437
台湾 ⑦Taiwan	615	642	602	512	2,372	1,492	1,027	793	1,079	4,392	1,639	1,299	894	1,793	5,626	1,805	1,106	1,150	962	5,024	1,265	1,220	1,852	1,457	5,795
韓国 ⑧Korea	435	375	219	2,573	3,604	637	119	219	352	1,328	592	583	1,139	330	2,645	1	392	−319	853	928	786	853	724	731	3,096
中国 ⑨China	1,801	746	−8	981	3,520	1,327	564	284	389	2,566	902	598	794	1,046	3,341	1,608	887	1,735	1,345	5,578	1,423	1,056	1,708	2,325	6,514
その他アジア ⑩Other asia	503	196	4,202	657	5,559	912	704	668	293	2,579	966	823	990	989	3,770	1,060	1,023	1,089	994	4,168	1,101	677	470	517	2,768
米州 ⑪America	44	19	27	25	117	99	16	112	34	263	17	330	49	467	864	266	130	39	173	611	25	248	552	239	1,065
欧州 ⑫Europe	43	4	46	9	104	16	13	42	62	134	20	16	50	2	89	27	49	15	142	234	8	44	159	26	240

※1 2016年3月期より会計方針の変更を行っているため、「2015/3」については、遡及適用後の数値を記載しております。

Ⅳ. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費（連結） Cash Flows and Capital Expenditures , Research and Development expenses（Consolidated）





（連結）	（Consolidated）					
決算期	Fiscal year	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3※1	2016/3
キャッシュフロー（百万円）	Cash flows（¥Millions）					
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	1,897	2,710	935	2,590	3,254
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	−112	−1,083	−1,553	−1,430	−1,806
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	−2,280	−817	819	−1,170	−868
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	4,395	5,266	5,533	5,617	6,027
設備投資額（百万円）	①Capital expenditures（¥Millions）	1,336	1,262	1,482	1,295	1,996
対売上高比率（%）	②Ratio of sales（%）	7.79	7.67	8.64	6.13	9.00
減価償却費（百万円）	③Depreciations（¥Millions）	1,181	1,354	1,314	1,199	1,311
対売上高比率（%）	④Ratio of sales（%）	6.89	8.23	7.66	5.67	5.91
研究開発費（百万円）	⑤Research and development expenses（¥Millions）	238	187	129	194	472
対売上高比率（%）	⑥Ratio of sales（%）	1.39	1.14	0.75	0.92	2.13

※1 2016年3月期より会計方針の変更を行っているため、「2015/3」については、遡及適用後の数値を記載しております。